

## ●USPQ-4B03 パッケージ許容損失

USPQ-4B03 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

### 1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基盤：銅箔 4 層基板 40mm×40mm (片面 1600mm<sup>2</sup>)

に対して銅箔面積

表面：全体 約 50%\_放熱板、リード 1 と接続

内層 1 層目：約 50%\_放熱板、リード 1 と接続

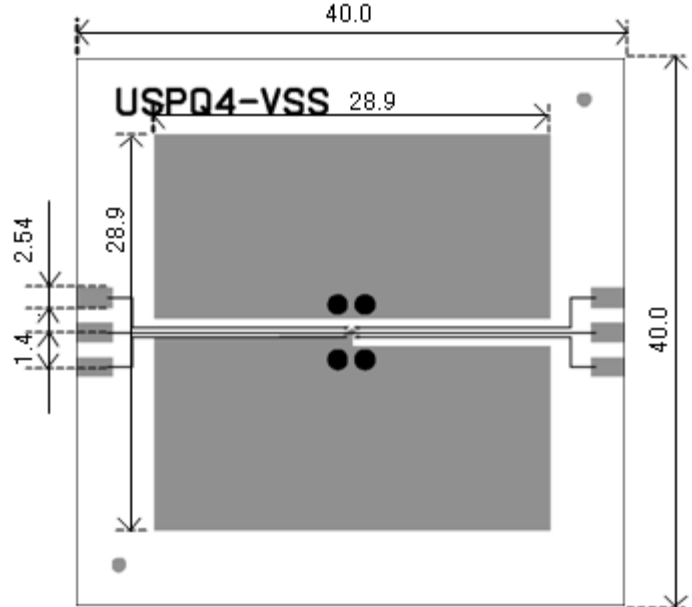
内層 2 層目：約 50%\_放熱板、リード 1 と接続

裏面：約 50%\_放熱板、リード 1 と接続

基板材質：ガラスエポキシ (FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：ホール径 0.8mm 4 個

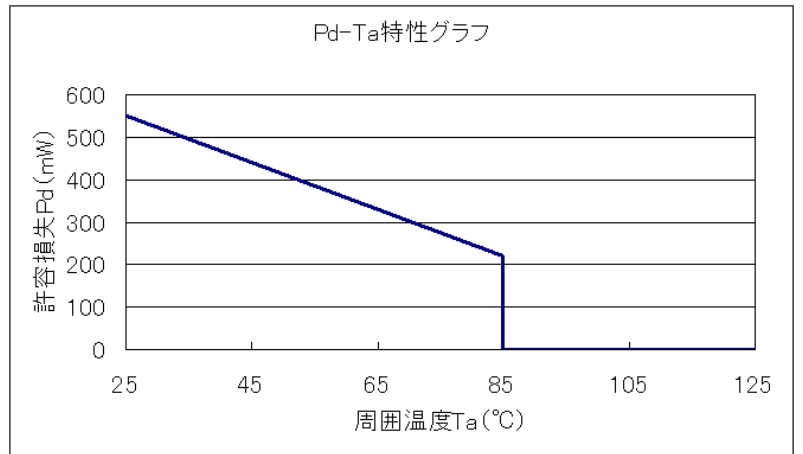


評価基板レイアウト(単位:mm)

### 2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装(  $T_{jmax}=125^{\circ}C$  )

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	熱抵抗(°C/W)
25	550	181.82
85	220	



基板実装(  $T_{jmax}=125^{\circ}C$  )

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	熱抵抗(°C/W)
25	550	181.82
105	110	

